



UF7570 半导体器件系列环氧树脂底部填充胶

技术支持与产品采购：吕乃昌，13851870840

➤ 简介

UF7570 为单组份环氧树脂底部填充胶，主要应用于半导体器件的底部填充粘接。

➤ 用途

本品具备优异的流动性能、优异耐化学性、不导电以及界面粘接性能，专为半导体器件底部填充而设计，能够渗透至细间距引线与深腔结构中，且不会产生气泡。可承受高温回流焊工艺的考验。适用于在 BGA、PBGA 封装、CSP 芯片级封装、低温共烧陶瓷 (LTCC) 基板上的全阵列封装，以及超细缝隙填充领域。

➤ 性能参数

	性能指标		条件	单位	指标值
固化前典型特征	外观		-40℃		黑色膏体
	博勒非粘度		@ 25℃, 5 rpm	mPa·s	50,000
	密度		室温	g/cm ³	1.8
	有效期		-40℃	月	3
固化特性	凝胶时间		120℃	min	12
	固化工艺	1	125℃	min	30
		2	165℃	min	90
固化后典型特征	邵氏硬度		GB/T 2411-2008	Shore D	>85
	玻璃化转变温度		GB/T 22567-2008	℃	150
	热膨胀系数(CTE)		GB/T 36800.2-2018	ppm/℃	18
	温度适用范围			℃	-65 ~ 150
	体积电阻率		GB/T 31838.2-2019	Ω·cm	>1×10 ¹⁶
	Na ⁺ 离子含量		GB/T 37861-2019	ppm	<15
	Cl ⁻ 离子含量		GB/T 37861-2020	ppm	<15
	介电常数/介质损耗因数		GB/T 1409-2006	—	3.5/0.01

➤ 使用说明

操作步骤如下：

- (1) 使用前请让容器恢复至室温；
- (2) 从冰柜中取出后，解冻期间应将针筒垂直放置；
- (3) 在室温下放置至触摸时不再发凉（通常需 60 至 90 分钟）；

- (4) 为获得最佳效果，应将本产品点涂在预热至 75℃ 的基板上；
- (5) 产品点涂后，应在 30 分钟内完成固化，以防受潮污染；
- (6) 受潮污染的产品，其固化后性能将低于前文所述性能参数；
- (7) 建议固化制度：125℃/30 分钟+165℃/90 分钟。

➤ 注意事项

- ✧ 切勿在烘箱中解冻；
- ✧ 从容器中取出的物料在使用过程中可能受到污染，请勿将产品倒回原容器；
- ✧ 环境温度升高会缩短产品的适用期；
- ✧ 本产品属非危险品，也请避免与眼和口直接接触。

➤ 包装

请联系销售人员获取有关包装尺寸和可用性的信息。

➤ 贮存和运输

- ✧ 本产品须密封贮存于原始的、密封的容器中，放在阴凉、干燥处，防止暴晒与雨淋，最佳贮存温度：-40℃，储存温度低于 -40℃ 或高于 -40℃，均可能对产品性能产生不利影响，有效期 3 个月；
- ✧ 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

➤ 请仔细阅读：

本文中所含的各种数据为本公司在实验室标准条件下测试所得，仅作参考，使用时以实际测试数据为准，所涉及的产品使用方法均只是本公司的建议，为确保材料在最终使用条件下的安全和适用，客户有必要通过实验确认产品的适用性，对在其它不同的仪器或条件下测试得到的数据，本公司不做任何承诺，客户自行将产品用于不适宜的用途所产生的后果，在适用法律允许的最大限度内，本公司特别声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

哈尔滨兴芯科技有限公司

公司地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷三街 4022 号碧海产业园 10 号楼